

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

# 오션브릿지(241790)

## 반도체/반도체장비

신규 공장 가동을 통한 생산능력 확대 및

신규 해외 고객사 확보를 통한 고객사 다변화 중

기업현황

주요 변동사항

재무분석



작성 기관

(주)나이스디앤비

작 성 자

김기훈 연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것입니다. 또한 작성기관이 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종 목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다.  
따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- **본 보고서는 '19.01.31.에 발간된 동기업의 기술분석보고서**에 대한 업데이트보고서입니다. 자세한 사항은 한국IR협의회(kirs.or.kr)와 한국거래소 상장공시시스템(KIND), 투자자종합정보포털(SMILE), 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에 등록된 기존 보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 (주)나이스디앤비(TEL.02-2122-1300)로 연락하여 주시기 바랍니다.



한국IR협의회

## I. 기업현황

반도체 관련  
케미칼 및 장비  
제조 판매 업체,  
오션브릿지

동사의 주요 주주  
및 종속회사 현황

오션브릿지(주)(이하 '동사')는 2012년 3월 현 대표이사 이경주에 의해 설립되었으며 2016년 12월 한국거래소 코스닥 시장에 상장되었다. 동사는 반도체 관련 케미칼 및 장비 제조 판매 업체로, 경기도 안성시 양성면에 본사를 두고 있으며, 보은군 삼승면 소재 제 2공장, 안성시 원곡면 소재 제 3공장을 보유하고 있다. 동사는 분기보고서(2019.11.12.) 기준 총 114명의 정규직원이 근무하고 있다.

동사의 최대주주는 이경주 대표이사로 동사 지분의 18.6%를 소유하고 있으며, 2대 주주는 자동차 부품 등 디지털 전자사업을 영위하는 코스닥 상장업체 남성의 대표이사로 동사 지분의 9.45%를 소유하고 있다. 동사의 연결대상 종속회사 (주)제일이엔지는 경기도 화성시에 위치하고 있으며, 반도체용 가스 공급 장치(Gas Supply System), 분배 장치(Valve Manifolder Box)의 제조업을 영위하고 있고, 우시해교전자기술은 중국 우시(Wuxi)에 위치하고 있으며, SK하이닉스 중국법인(SK hinx Wuxi)의 중설에 맞춰 동사의 반도체 관련 케미칼과 장비를 원활하게 공급하기 위한 거점 역할을 수행하고 있다.

[표 1] 주요주주 및 종속회사 현황

주요주주	지분율(%)	회사명	지분율(%)
이경주	18.60		
윤남철	9.45	(주)제일이엔지	44.25
이다솜	5.33		
이예습	5.25		
기타	61.37	우시해교전자기술	100
합계	100		

\*출처: 동사 분기보고서(2019.11.12), 나이스디앤비 재구성

동사의 주요 사업은 반도체 케미칼 및 반도체 장비 개발 및 제조 사업으로 주요 고객사는 SK하이닉스이다. 주요 제품으로는 반도체 케미칼 분야에 프리커서(Precursor)로 분류되는 HCDS<sup>1)</sup>, TiCl<sub>4</sub><sup>2)</sup> 등이 있으며, 반도체 장비로는 케미칼 공급장치(Central Chemical Supply, 이하 CCSS)와 슬러리 공급장치(Slurry Supply System, 이하 SSS) 등이 있다.

차세대 반도체용  
신규 프리커서 및  
반도체 장비 개발을  
수행 중

동사에서 생산 중인 HCDS, TiCl<sub>4</sub> 등의 프리커서는 반도체 소자용 박막, 증착용 재료로서, 반도체 소자의 초 미세화, 고 집적화에 따라 수반되는 필수 소재로 반도체 소자 제조 시 절연막/금속 배선 등으로 사용된다. 동사는 HCDS 및 TiCl<sub>4</sub>의 상용화 제조기술 개발 등을 통한 원재료 자체 조달 생산방식 전환으로 수익성을 제고하고 있으며, 높은 열 안정성을 가진 차세대 반도체용 신규 High-K 프리커서 개발을 위한 기술을 개발하고 있다.

1) HCDS(Hexa Chloro Di Silane): 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 사용되는 프리커서로, 주로 반도체 DRAM과 Nand Flash 메모리 생산 공정에 절연막으로 사용된다.



반도체 장비 부분에서는 화학물질 공급장치인 CCSS와 SSS를 제조, 설치, 유지보수하는 사업을 영위하고 있다. 화학물질 공급장치는 여러 가지 화학 물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계 된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치로, 반도체 공정(전/후 공정)에 필수 요소로 적용되는 장비로서 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정개선에 따라 지속적인 수요가 발생되는 제품이다. 동사는 반도체 장비의 지속적인 기술 내재화를 통해 원가경쟁력을 확보하고 차세대 반도체 산업에 적용될 장비의 핵심 제품의 개발을 추진하고 있다.

동사는 2018년 실적 기준 각 부분별 매출 비중은 반도체 장비 52.6%, 반도체 케미칼 42.1%, 부품 및 기타 5.3%로, 대부분 반도체 장비 및 케미칼을 통해 매출이 발생하고 있다.

[표 2] 동사의 연구개발 실적

내용	개발기간	연구기관
HCDS 상용화 제조 기술	2013. 7 ~ 2013. 12	당사 자체 개발
	2013.12 ~ 2014. 5	당사 자체 개발
TiCl <sub>4</sub> 상용화 제조 기술 개발	2015.12 ~ 2016. 2	당사 자체 개발
	2015.11 ~ 2016. 3	당사 자체 개발
고점도 케미칼 공급 장치를 위한 기술 개발	2014. 3 ~ 2014. 7	당사 자체 개발
	2014. 4 ~ 2014. 8	당사 자체 개발
Ceria 슬러리 공급 장치 내재화를 위한 기술 개발	2015. 8 ~ 2018.12	당사 자체 개발
	2016. 2 ~ 진행 중	자체연구 및 협력사 협업
Tungsten 슬러리 공급 장치 내재화를 위한 기술 개발	2016. 8 ~ 진행 중	자체연구 및 협력사 협업
	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
BOE 300:1 Bulk 공급 장치 내재화를 위한 기술 개발	2015. 8 ~ 2018.12	당사 자체 개발
	2016. 2 ~ 진행 중	자체연구 및 협력사 협업
N2 Side Storage 장치 내재화를 위한 기술 개발	2016. 8 ~ 진행 중	자체연구 및 협력사 협업
	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
차세대 반도체용 New High-K 프리커서 개발	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
반도체 특수가스 기술 내재화	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
Bulk Mixing 공급 장치 내재화	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발
	2016. 8 ~ 진행 중	당사 자체 개발

\*출처: 동사 분기보고서(2019.11.12), 나이스디앤비 재구성

2) TiCl<sub>4</sub>: 반도체 메모리 소자 제조 시 전자를 보관하는 커패시터의 전극 물질로, 질화티타늄으로 증착되어 확산방지막 역할로 사용된다.

## II. 주요 변동사항

- ▶ 신규 공장 준공(2018년) 및 가동(2019년)
- ▶ 신규 해외 고객사 확보 및 고객사 다변화

### 종속회사

(주)미래하이트론

흡수합병으로 경영  
효율성 제고

합성, 정제, 충진,  
포장을 일괄적으로  
수행할 수 있는

In Line 생산시스템이  
구축된 신규 공장  
가동 시작

동사는 기존의 종속회사였던 (주)미래하이트론을 흡수합병하였다. (주)미래하이트론은 2013년에 설립되어 경기도 성남시 분당구에 본사를 두고 있으며, 반도체 웨이퍼 영업과 관련된 자문 제공을 목적으로 설립된 기업이다. 동사는 2017년 4월 사업 다각화를 목적으로 (주)미래하이트론의 지분 50%를 인수하였으며 2018년 12월 영업자문 및 서비스업의 시너지를 높이기 위해 (주)미래하이트론을 흡수합병 하였다.

동사는 반도체 케미칼 생산량 증대를 위해 320억 원을 투자하여 2018년 신규 공장(제 2공장)을 완공하였으며, 2019년 공장 가동을 시작하였다. 신규 공장은 충청북도 보은군 삼승면 보은산업단지 내 위치하고 있으며 동사가 보유한 전체 15,000평 부지 중 약 4,000평에 해당하는 면적을 차지하고 있다. 동사는 신규 공장에 각 제품별 합성, 정제, 충진, 포장을 일괄적으로 수행할 수 있는 In Line 생산 시스템을 구축하였으며 공정 및 안전관리를 중앙관리실에서 통합·관리 가능한 시스템을 구축하였다.

[그림1] 보은 신규 공장(제 2공장) 전경



\*출처 : 오션브릿지 제공

**Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 합성과 정제  
를 모두 진행할 수  
있는 기술력 확보,  
신규공장에서 생산**

동사는 신규 공장에서 기존에 외부 생산을 통해 공급했던 반도체용 특수가스인 Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub><sup>3)</sup>를 자체 생산할 예정이다. 특수가스는 반도체 제조 및 연구용, 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD, Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) 등 다양한 용도로 사용되며, 초고순도가 요구되고 미세한 공정에 사용되다 보니 작은 결함으로도 웨이퍼에 막대한 피해를 발생할 수 있는 중요성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 산업이다. 동사는 2017년 자체 개발을 통해 Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub>의 합성과 정제를 모두 진행할 수 있는 기술(특허등록 제10-1810498, 다이실란 합성 및 정제 장치)을 확보하였으며, Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub>를 시작으로 생산되는 제품 수를 늘릴 예정이라 밝혔다.

3) Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub>(다이실란): 반도체 제조공정 중 확산 및 증착(CVD, Chemical Vapor Deposition) 공정에 사용되는 특수가스이다.



또한, 동사는 보유 경제 기술을 기반으로 한 저순도 원자재의 고부가가치화와 케미칼 제품 분야 다변화를 추진하고 있다.

**SK하이닉스로의  
제품 납품을 위한  
시제품 테스트 중**

한편, 동사는 현재 신규 공장에서 생산된 시제품을 SK하이닉스로의 제품 납품을 위해 테스트 중이며, 시제품 테스트가 성공적으로 완료되고 수주를 통해 매출로 이어진다면 특수가스 매출이 포함되는 동사의 반도체 케미칼 분야 매출과 수익 증대로 이어질 것으로 기대된다. 한편, 동사의 관계자에 따르면 동사는 현재 추가적인 생산 시설 증축을 위해 1차 투자를 완료한 단계이며, 남은 부지(11,000평)를 활용하여 2020년에 2차 투자를 진행할 계획이라 밝혔다.

**신규 해외 고객사  
확보 및  
고객 다변화 중**

동사의 주요 매출처는 SK하이닉스(2018년 기준 동사 매출의 약 43% 차지<sup>4)</sup>)로서, 편중된 매출구조를 개선하기 위해 신규 해외 고객사 확보를 진행하고 있다. 동사는 최근 신규 거래업체인 중국의 케링턴테크놀로지(Kelington Technologies Sdn Bhd)와 2019년 8월 25억 원 규모의 반도체 장비 공급계약을 체결하였으며, 2019년 9월에는 중국 피엔씨 테크놀로지(PNC Technology Co., Ltd)와 19억 원 규모의 반도체 장비 공급계약을 체결하였다. 또한, 동사는 중국의 중국 최대 반도체 위탁생산 업체 SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corporation)와 반도체 케미칼 소재 공급을 위해 시제품 테스트를 하고 있는 등 해외 시장 개척을 통한 고객 다변화를 추진하고 있다.

**[표 3] 오션브릿지 최근 수주현황**

수주 일자	제품	계약 기간	계약상대방	금액
2019.08.15	반도체 장비	2019.08.15. ~2019.10.31	SK하이닉스(China)	47억 원 규모
2019.08.19	반도체 장비	2019.08.19. ~2019.11.20	Kelington Technologies Sdn Bhd	25억 원 규모
2019.09.23	반도체 장비	2019.09.23. ~2019.11.30	SK하이닉스	20억 원 규모
2019.09.29	반도체 장비	2019.09.29. ~2019.12.30	PNC Technology Co., Ltd	19억 원 규모
2019.12.11	반도체 장비	2019.12.11. ~2020.03.31	SK하이닉스	191억 원 규모

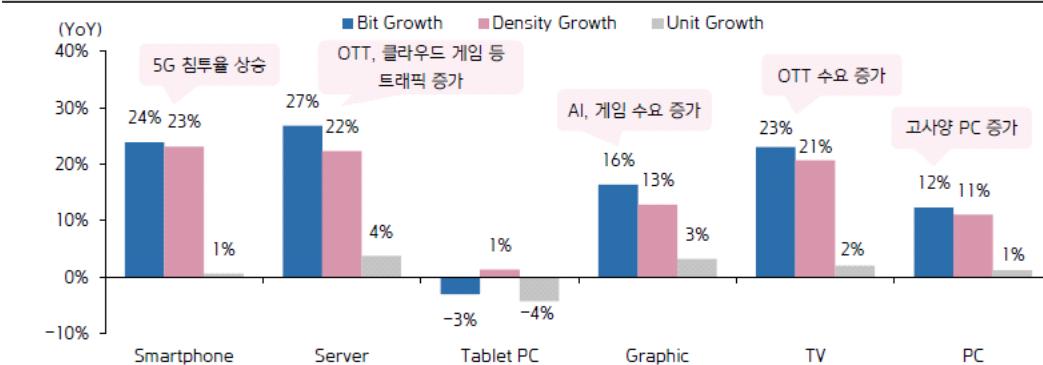
\*출처: 동사 분기 보고서(2019.11.12), 나이스디앤비 재구성

**5G 통신장비 성장에  
따른 DRAM이  
산업의 수요성장을  
이끌 전망**

시장조사업체 퍼시스턴트마켓리서치의 2018년 자료에 따르면 5G 통신장비는 2025년까지 연간 59.3%씩 성장할 것으로 전망되고 있다. 5G 통신장비 시장의 호조세에 따라 5G 산업 성장의 직접적인 수혜가 예상되는 서버 DRAM과 모바일 DRAM이 산업의 수요성장을 이끌 전망이며, PC DRAM 역시 신규 CPU 출시 및 고사양 제품 판매 확대에 힘입어 견조한 성장세를 이어나갈 것으로 전망된다. 이에 반도체에 대한 투자와 함께 후방산업인 반도체 소재 업체의 추가 소재 공급 확대의 기회 요인으로 작용할 것으로 추정된다.

4) 출처 : 한국신용정보원, 오션브릿지 기업비즈맵

[그림 2] 2020년 DRAM 수요전망



\*출처: DRAMeXchange, Gartner, 키움증권 리서치센터, 나이스디앤비 재구성

## 2019년 4건의 신규 특허 취득

동사는 기존에 보유하고 있던 특허권 6건, 실용신안권 1건 외에 2019년 1월부터 6월까지 동사 주요 제품에 적용되는 4건의 신규 국내 특허를 취득하여 2019년 12월 현재 총 11건의 지식재산권을 보유하고 있다.

[표 4] 2019년 신규 취득 특허권

등록 일자	등록번호	발명의 명칭
2019.01.04	10-1937477	웨이퍼 자동 관리 장치용 챔버
2019.01.22	10-1943210	웨이퍼 자동 관리 장치
2019.05.14	10-1980437	관리효율이 향상된 웨이퍼 자동 관리 장치용 챔버
2019.06.21	10-1993686	챔버 교체가 가능한 웨이퍼 자동 관리 장치

\*출처: 특허정보넷 키프리스, 나이스디앤비 재구성

동사가 올해 취득한 특허들은 반도체 장비에 관한 기술로서, 웨이퍼가 각 공정(증착, 연마, 포토리소그래피, 식각 등)에서 요구되는 특정 위치로 운반될 때 이물질과 품(Fume)을 제거하는 공정을 거치게 되는데 이때 이물질과 품의 분리율을 향상시켜 배출시킴으로써 웨이퍼 관리효율을 향상시킬 수 있는 웨이퍼 자동 관리 장치와 챔버에 관한 것이다.



## IV. 재무분석

동사는 반도체 관련 케미칼 및 장비 등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2018년도 실적 기준 매출 비중은 반도체 장비 사업부문 52.6%, 반도체 케미칼 사업부문 42.1%, 부품 및 기타 5.3%로 대부분 반도체 장비 및 케미칼을 통해 매출이 발생하고 있다. 반도체 장비사업 부문의 주요 품목은 CCSS(Central Chemical Supply System)와 SSS(Slurry Supply System) 등이 있으며, 반도체 케미칼 사업부문은 HCDS, TiCl<sub>4</sub>, BDEAS(미세페인 소재), BTBAS(Tox 박막소재), DIPAS(증착용 소재) 등이 있다. Ion Implant Parts, O-ring 등의 부품도 판매하고 있다.

[표 5] 동사 요약 손익계산서

(단위 : 억원, %, K-IFRS 2017, 2018년 연결)

구분	2016년 [별도]		2017년		2018년	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
매출액	350	100.0	560	100.0	942	100.0
매출원가	256	73.2	412	73.6	711	75.5
매출총이익 (손실)	94	26.8	148	26.4	231	24.5
판매비와 관리비	25	7.0	33	5.8	58	6.1
영업이익 (손실)	69	19.7	115	20.6	173	18.3
영업외수익	12	3.5	3	0.5	5	0.5
영업외비용	7	2.1	20	3.6	8	0.9
법인세비용 차감전순이 익(손실)	74	21.1	98	17.5	170	18.0
법인세비용	9	2.7	8	1.5	29	3.1
당기순이익 (손실)	64	18.4	90	16.0	141	14.9

\*동사는 2016년 연결재무제표 작성대상이 아닌 바, 별도 재무제표를 기재함

**반도체**

최근 3개년간 반도체 케미칼과 반도체 장비 사업부문의 전반적인 수주물량 확대로 매출증가세를 나타냈으며, 2017년 전년대비 증가한 560억 원 [+60.0%, YoY], 2018년 전년대비 증가한 942억 원 [+68.2%, YoY]를 기록하였다.

**제조업체로부터  
수주물량 확대로****매출증가세**

[표 6] 주요 사업부문 매출실적 및 증가율

(단위 : 억원, %)

구분	2016년 [별도]		2017년		2018년	
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
케미칼	216	51.4	250	15.7	311	24.4
장비	91	30.0	235	158.2	388	19.4

**외주비, 원재료비  
등의 부담확대로  
수익성 다소 저하**

2018년 원재료비, 인건비, 외주비 등의 전반적인 비용 상승으로 매출액영업이익률이 전년 대비 감소한 18.3% [-2.3%p, YoY]를 기록한 가운데, 이자비용, 외환차손, 잡손실 등의 발생에 따른 영업외수지 적자로 매출액순이익률도 전년 대비 감소한 14.9% [-2.3%p]를 기록하며 전반적인 수익성이 전년대비 저하되었다.

[표 7] 동사 요약 분기 손익계산서

(단위 : 억원, %, K-IFRS 연결)

구분	2018년 3분기		2019년 3분기	
	금액	구성비	금액	구성비
매출액	635	100.0	551	100.0
매출원가	482	76.0	409	74.2
매출총이익 (손실)	153	24.0	142	25.8
판매비와 관리비	42	6.6	44	7.9
영업이익 (손실)	110	17.4	99	17.9
영업외수익	4	0.7	8	1.5
영업외비용	9	1.4	9	1.6
법인세비용차감전 준이익(손실)	106	16.6	98	17.8
법인세비용	14	2.2	16	3.0
분기순이익 (손실)	92	14.4	82	14.8

**2019년 3분기까지**

**장비사업 부문 수주  
물량 감소, 전년 동기  
대비 매출외형 축소**

**원가부담 절하로  
수익성 전년 동기  
수준 자속**

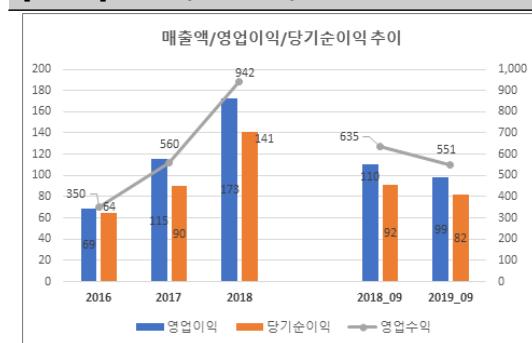
**SK하이닉스로부터  
반도체 장비 신규  
수주확보**

2019년 3분기까지 반도체 장비 사업부문의 경우 전년 동기 380억 원 대비 53.4% 감소한 177억 원의 매출액을 시현하는데 그친 가운데, 케미칼, 부품 사업부문에 대한 수주물량도 감소세를 나타내며 2019년 3분기까지 전년 동기 대비 13.2% 감소한 551억 원의 매출액을 시현하였다.

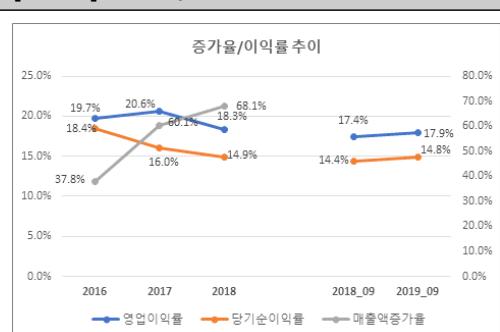
2019년 3분기까지 매출하락 등에 따른 판관비 부담 확대에도 불구하고 원가부담 절하로 매출원가율이 더욱 감소하여 매출액영업이익률은 전년 동기 대비 증가한 17.9% [+0.5%p, YoY]를 기록한 가운데, 이자비용 등의 발생에 따른 영업외수지 적자로 영업이익률을 하회하는 14.8%의 매출액순이익률을 시현하였다.

한편, 동사는 SK하이닉스로부터 M16 Ph-1 Project 반도체제조장비(CCSS 외) 공장제작 및 납품에 대한 구매의향서(LOI)를 수령 사실을 2019년 12월 11일 공시하였으며, 공시자료 기준 예상 납품 금액은 191억 원 가량으로 2018년 연결 매출의 20.2% 수준이다. 납품기한은 2020년 3월 31일이며, 추후 본 계약체결 시 변동될 수 있는 것으로 조사되었다.

[그림 3] 매출액/영업이익/당기순이익 추이



[그림 4] 증가율/이익률 추이



\*출처: 동사 IR 자료, 나이스디앤비 작성



[표 8] 동사 요약 재무상태표

(단위 : 억원, %, K-IFRS 2017, 2018년, 2019년 3분기 연결)

구분	2016년[별도]		2017년		2018년		2019년 3분기	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	316	88.2	330	54.7	394	48.4	351	45.8
비유동자산	42	11.8	274	45.3	419	51.6	415	54.2
<b>자산총계</b>	<b>358</b>	<b>100.0</b>	<b>604</b>	<b>100.0</b>	<b>813</b>	<b>100.0</b>	<b>766</b>	<b>100.0</b>
유동부채	49	13.6	177	29.4	265	32.6	140	18.2
비유동부채	0	0.0	17	2.9	0	0.0	1	0.2
<b>부채총계</b>	<b>49</b>	<b>13.6</b>	<b>195</b>	<b>32.3</b>	<b>265</b>	<b>32.6</b>	<b>141</b>	<b>18.4</b>
자본금	46	12.7	46	7.6	46	5.6	48	6.2
자본잉여금	153	42.7	160	26.5	160	19.7	189	24.7
자본조정	0	0.0	(5)	(0.8)	(24)	(2.9)	(23)	(3.0)
기타포괄 손익누계액	0	0.0	0	0.0	(0)	(0.0)	0	0.0
이익잉여금 (결손금)	111	30.9	200	33.1	330	40.5	364	47.5
소수주주지분	0	0.0	8	1.4	36	4.5	48	6.3
<b>자본총계</b>	<b>309</b>	<b>86.4</b>	<b>409</b>	<b>67.7</b>	<b>548</b>	<b>67.4</b>	<b>625</b>	<b>81.6</b>
<b>자본과 부채총계</b>	<b>358</b>	<b>100.0</b>	<b>604</b>	<b>100.0</b>	<b>813</b>	<b>100.0</b>	<b>766</b>	<b>100.0</b>

\*동사는 2016년 연결재무제표 작성대상이 아닌 바, 별도 재무제표를 기재함

## 매출규모 확대로 영업 부채도 확대

2018년 12월 말 기준 순이익의 내부유보에 따른 자기자본 확충에도 불구하고 매입채무 등의 부채 규모 확대가 이를 상쇄하여 부채비율은 전년 말과 비슷한 수준인 48.3% [+0.6%p, YoY]를 기록하였다.

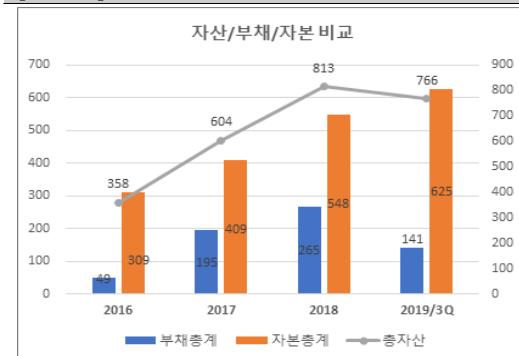
## 부채비율 등 주요 재무안정성 지표 전년 대비 저하

한편, 장비 공장 증설 등으로 2018년 말 기준 유형자산의 규모가 전년 말 대비 확대된 376억 원 [+53.3%, YoY]를 기록한 가운데, CCSS / SSS 등의 반도체 장비 생산능력이 더욱 확대될 것으로 전망된다.

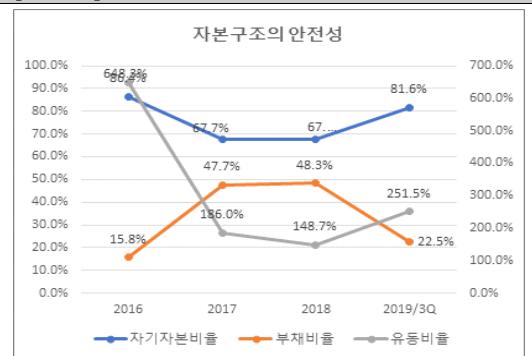
## 유동부채는 동사 소유 순운전자본으로 충분히 상환 가능한 수준

동사는 2018년 10월 19일 이사회결의를 통해 2018년 12월 31일을 합병기일로 종속기업인 (주)미래하이트론을 흡수합병하였다. 동일 지배하의 종속기업 합병에 의한 사업결합으로 인하여 취득한 자산과 인수한 부채는 연결재무제표상의 장부금액으로 인식하였고, 제거되는 종속기업투자주식과의 차이를 자본잉여금으로 반영하였다.

[그림 5] 자산/부채/자본 비교



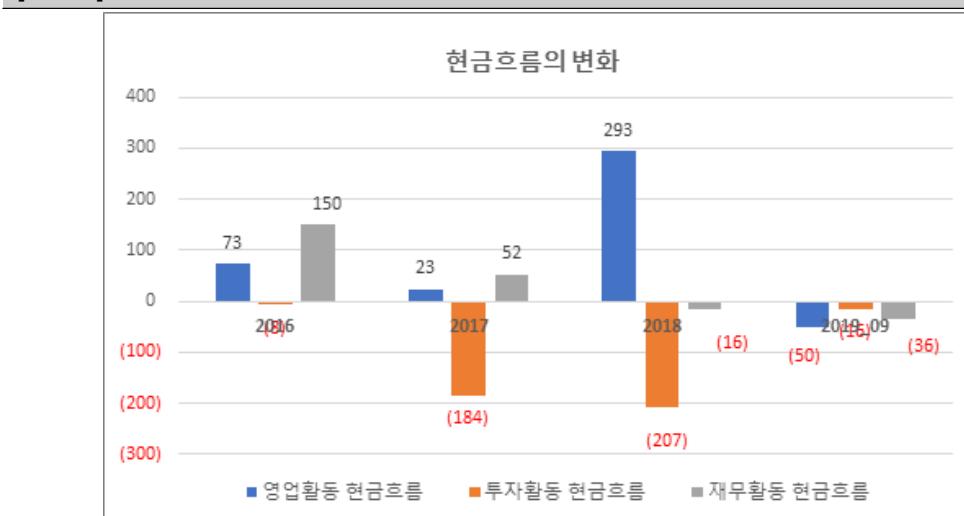
[그림 6] 자본구조 안정성



\*출처: 동사 IR 자료, 나이스디앤비 작성

유형자산 및  
단기금융상품  
취득 등에 따른  
현금유출로  
기말현금 규모  
기초 대비 축소

[그림 7] 동사 현금흐름의 변화



\*출처: 동사 IR 자료, 나이스디앤비 작성

2018년 순이익 시현, 감가상각비 등의 현금유출이 없는 비용의 가산으로 영업활동 양(+)의 현금흐름을 나타낸 가운데, 차입금 상환, 유형자산의 취득 등 투자활동 및 재무활동 상의 현금 유출을 상기 영업활동상 유입된 현금으로 충당하는 현금흐름을 나타내었다. 현금잔고는 2018년 기초 140억 원에서 기말 210억 원으로 증가한 것으로 확인되었다.

2019년 3분기까지  
반도체 장비 부문  
실적하락 보였으나,  
SK하이닉스 수주로  
일부 회복 가능성

2019년 3분기까지 반도체 장비 사업부문의 경우 전년 동기 380억 원 대비 53.4% 감소한 177억 원의 매출액을 시현하는데 그치며, 누적 매출은 전년 동기 대비 13.2% 감소한 551억 원의 매출액을 시현하였다. 그러나, 2019년 12월 11일 공시 자료 기준, SK하이닉스로부터 191억 원 가량의 신규수주를 확보한 것으로 확인되며, 이에 따라 전년과 유사한 수준의 매출외형 유지도 가능할 것으로 분석된다.

증권사 투자의견

[표 9] 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
하나금융그룹	Not Rated	-	2019.10.25
	· 주요 고객사 시설투자 감소하지만 인프라 투자는 지속 · 신규 고객사, 신규 제품, 중장기 로드맵 이상 無		
키움증권	Not Rated	-	2019.07.23
	· NAND 업황 텐어라운드, 반도체 신규 소재 공급 확대 · 중국 SMIC 진입, 고객 다변화 성공!		